

CAT-2500(2500P)

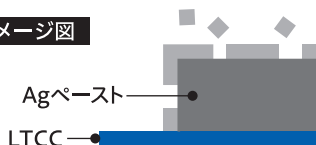
LTCC/Agペースト上Ni/Pd/Au(Ni/Pd-P/Au)プロセス

LTCC基板は高周波モジュールやICパッケージ基板として幅広く使用されています。CAT-2500プロセスはこのLTCC基板/Agペースト品に対するプロセスとなります。

特長

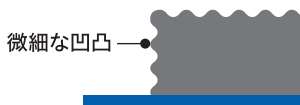
- ① 従来の仕様と比べて貴金属の薄膜化が出来るので、コストダウンが可能です。
- ② L&S30μm以下のファインパターンにも対応出来ます。
- ③ ハンダ付け性(Pbフリー対応)、W/B性、耐熱性、耐酸化性に優れています。
- ④ 特別なテクニックは必要なく、容易に処理が出来ます。

イメージ図



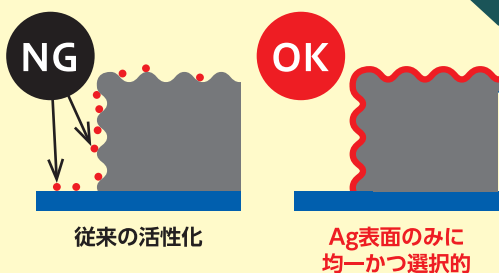
コンディショナー LT-2000C, PT-0 etc

ペースト中に含有される成分を侵すことなく、表面の汚れや酸化被膜のみを除去し、濡れ性を付与します。



エッチング HN-25, MC-E etc

アンカー効果による密着を得るため、微細な凹凸を付けます。



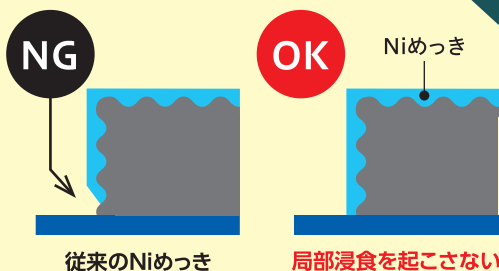
活性化

AT-90 AT-90L-2J etc

Ag表面を反応させるため、スタータとなる触媒を付与します。

特長

Ag表面のみに均一かつ選択的に吸着するので、LTCC上のリークやブリッジを起こしません。



Niめっき

リンデン203KN リンデン204N, リンデン57 etc

ファインパターン対応のLTCC専用のめっき液です。

特長

パターンエッジまで取り残すことなくしっかり付周ります。局部浸食を起こさないので、導体剥離が起きません。



Pdめっき

浴の安定性が高く、選択性に優れる皮膜が得られます。バリア層となってAu表面にNiを拡散させないため、リフロー等の熱処理した際に酸化せず、W/B性やハンダ濡れ性の低下を防ぐ効果があります。

CAT-2500 PD-100, PD-200 CAT-2500P PD-1, PD-1K

純Pdを使用します。W/B性を求められる際はこちらを選択します。

Pd-Pを使用します。ハンダ接合性を求められる際はこちらを選択します。



フラッシュ Au(ハンダ接合仕様)

MN-AUA, MN-AUG, MN-AUQ etc

ブラックパットを引き起こしにくい皮膜が得られますので、皮膜性能を損ないません。



厚付けAu(W/B仕様)

GOLD8, GOLD9, GOLD9L etc

Pd-Pを使用します。ハンダ接合性を求められる際はこちらを選択します。
*仕様に応じて処理して下さい。

上記工程は一例です。導体ペースト種等により工程を変更する場合があります。